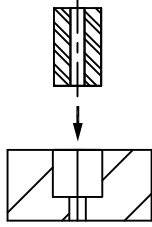
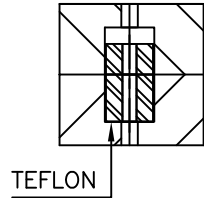


■조립방법 (JIG : DEQ01173-N/1 사용)

<STEP 1> 절연체 삽입

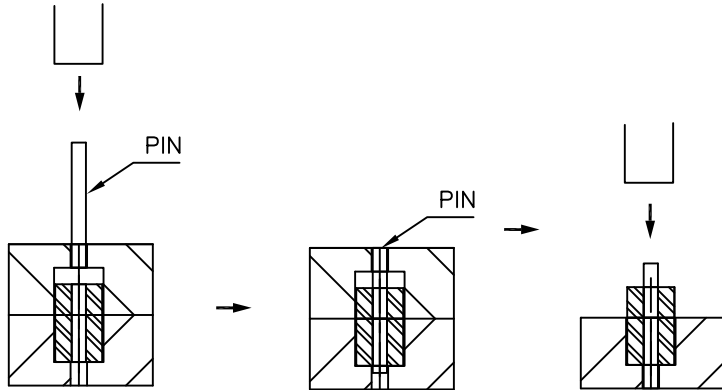


<STEP 2> JIG 위/아래 체결 (작업성에 따라 볼트 체결 유/무 결정, 접시머리 M2.3 5mm)



<STEP 3> 핀셋 이용하여 핀 삽입 후 하이스핀으로 핀 끝까지 삽입

<STEP 4> 윗면 JIG 해체 후 하이스핀으로 핀 끝까지 삽입



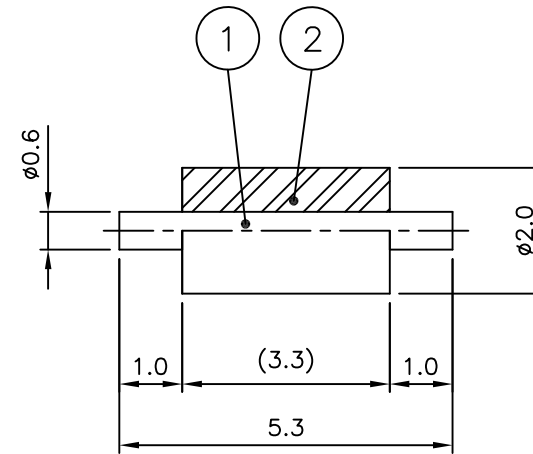
* 조립 후 검사 주의사항

1. PIN+절연체 조립시 헐겁지 않게 관리 필요.

(발주 진행 시 PIN 한도 견본을 절연체 외주 가공업체에 전달하여
조립 후 길이나 절연체가 헐겁지 않게 관리 될 수 있도록 내용 전달 필요.)

REVISION

REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	S.H.KIM	2022.12.09.



2	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02927-N/B
1	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT03914-5/9
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal ±0.2	DATE 2022. 12. 09.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	
	Angle ±1°	APPROVED BY	S.H.KIM			
MATERIAL _____	CHECKED BY	TITLE BUSHING				
	DRAWN BY					S.Y.EUN
FINISH _____	SCALE 8/1	UNIT mm		A4		DWG NO. CN03890-7/C
						REVISION I R